

# Karta techniczna

## Easy Print /Sn62 Pb36 Ag2/

### Opis:

Pasta przeznaczona do lutowania elementów w montażu powierzchniowym SMD.

### Zalety:

- odporna na zjawisko kuleczkowania (mid chip solderballing),
- dobra przyczepność do elementów przez ponad 24 godziny od jej nałożenia,
- pasta oddaje wiernie kontury nawet przez 8 godzin ciągłego druku, co zapewnia jej przedłużony czas przydatności (stencil life),
- minimalne, bezbarwne, niekorozyjne pozostałości po lutowaniu (no clean), które dzięki swojej elastyczności ułatwiają przenikanie igieł testerów,
- pasta posiada dużą wierność odtwarzania szczegółów (fine pitch),
- możliwości druku z prędkością rakli do 150 mm/s.

### Właściwości fizykochemiczne:

Właściwości	Wartość	Normy
<b>Chemiczne</b>		
rodzaj spoiwa	Sn62Pb36Ag2	
klasyfikacja topnika	REL - 0	J-STD - 004
test chromatografii bibułowej na Cl	spełnia (REL - 0)	IPC TM 650
<b>Fizyczne</b>		
gęstość	≈ 4,6 g/cm <sup>3</sup>	IPC-TM 650T
uziarnienie	25-45 μm	IPC-TM 650T
kleistość	1,0 G/mm <sup>2</sup> po 24h	IPC J-STD - 005
przydatność do druku	ponad 8h	
<b>Elektryczne</b>		
SIR-IPC	> 2,6*10 <sup>9</sup> Ω, pomiar po 7 dniach	IPC J-STD 004 (85°C, w 85%)

Symbole:

SIR - Surface Insulation Resistance - oporność powierzchniowa rezystancji

IPC - J STD 004/ 005, IPC - TM650 - amerykańskie normy definiujące wymagania techniczne past i topników

## Wymagania aplikacyjne:

Magazynowanie	Drukowanie	Lutowanie rozpltywowe	Mycie
<ul style="list-style-type: none"> <li>przechowywać w temp. 3-7°C przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w pojemnikach szczelnie zamkniętych</li> <li>najlepsza (optymalna) temp. nakładania pasty: 23-26°C</li> <li>temperatura max. nakładania pasty 28°C</li> <li>aby uniknąć zmian właściwości smarnych pasty nie należy łączyć zużytej ze świeżą</li> <li>aby nie dopuścić do kondensacji wilgoci i uzyskać odpowiednią właściwość pasty przed jej otwarciem należy doprowadzić ją do temperatury otoczenia przez okres kilku godzin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>szablony cięte laserem lub elektroformowane: 100 µm dla rasta = 0,4mm 150 µm dla rasta &gt; 0,5 mm</li> <li>zalecane rakle metalowe</li> <li>szybkość rakli w drukarce: 25- 150 mm/sek</li> <li>nacisk na rakle: 1.5-3N na cm długości</li> <li>ilość pasty na szablonie: watek grubości 15-20 mm rolujący się przed raklą</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>możliwe są wszystkie sposoby lutowania (w atmosferze normalnej i w azocie)</li> <li>podgrzewanie wstępne: stały wzrost 1-2,0°C/s aż do temp. 145-160°C lub max. 210-220°C dla wersji bez plateau</li> <li>faza plateau (jedynie dla pakietów o dużym zagęszczeniu elementami o różnej masie) 145-160°C przez 60-90 s</li> <li>lutowanie - faza rozpltywu: 30-90 s powyżej 180°C</li> <li>chłodzenie: gradient: 1-2°C/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pasta jako „no clean” nie wymaga zasadniczo mycia</li> <li>jeżeli mycie jest niezbędne polecamy Zmywacz PCB alkoholowy.</li> </ul>

## Opakowania:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
1,4 ml	strzykawka	5	ART.AGT-023
20 g	kartusz	1	ART.AGT-024
40 g	kartusz	1	ART.AGT-025
250 g	plastikowe pudełko	1	ART.AGT-031
500 g	plastikowe pudełko	1	ART.AGT-027